

DOW 2577D

1. 개요

DOW 2577D는 인쇄 회로나 기타 전자 기판상에 얇은 층으로 도포 되는 실리콘 보호 코팅제 입니다. 이런 실리콘 보호 코팅제는 부품이나 인쇄회로 기판을 장기간 신뢰성을 유지할 수 있도록 보호 역할을 하게 됩니다.

2. 용도

경성 및 연성 인쇄회로기판, 다양한 세라믹 회로 및 복합 회로, 부품, 커넥터의 내마모성 보호용 코팅으로 적용할 수 있습니다

3. 특성

- 일액형 상온 경화형 제품
- 열에 의한 가속 경화
- UV 지시약 함유
- 우수한 내습성
- 우수한 부착성

4. 일반적인 특성

항목	특성	비고
주요 성분	실리콘	
외관	반투명 액체	
점도 비중 @25°C, cps	80~250	
불휘발분 @150°C, %	50~65	
비중 @25°C(액상)	0.95~1.05	
비중 @25°C(경화후)	1.05~1.15	
표면경화시간 @25°C, min	< 50	
경도 비중 @25°C, Shore D	> 15	
경도 비중 @25°C, Shore A	> 75	
절연파괴강도 Kv/min	> 20	
체적 저항 $\Omega^* \text{ cm}$	> 5E+13	
수분 흡수율 @23°C, 24hr, %	0.05	
사용 온도 범위	-50~200°C	

5. 보관 및 저장

DOW 2577D

일반적으로 밀폐 용기 내에서 12개월간 저장이 가능합니다. 가장 효과적으로 사용하기 위해서는 25°C 이하에서 수분과 접촉하지 않도록 각별한 주의가 요구되며 용기를 단단히 밀폐하여 내부에 공기가 들어가는 것을 최소화해야 합니다.

6. 포장

- 1kg Steel can, 10pcs/Box

7. 적용방법 및 경화 조건

일반적으로 스프레이, 브러시, 플로우, 딥 또는 자동화 패턴 코팅 사용이 가능합니다. 스프레이 작업에서는 용제로 희석하여 점도를 낮추어 사용하는 것이 바람직합니다.

도막 두께에 따라 차이를 보이지만 일반적으로 75micron 두께로 코팅 시, 상온에서 10분간 방치하고 다시 60°C로 10분간 가열하면 완전 경화가 이루어집니다.

도막에 열을 가하여 경화 시간을 단축시킬 수 있지만 용제가 충분히 휘발 되지 않은 상태에서 가열 경화 시 도막이 부풀거나 내부에 기포가 발생할 수 있으므로 용제가 휘발 될 수 있는 충분한 시간이 필요합니다.

8. 접착

당사 보호용 코팅제는 대부분의 일반적 전자 기판과 재료들에 접착되도록 제조되었습니다. RTV 코팅제의 경우, 일반적으로 경화 반응이 느리게 진행되며 일부는 완전한 경화까지 72 시간이 소요 되기도 합니다. 낮은 표면 에너지를 가져 접착이 어려운 경우, 화학적 에칭 또는 플라즈마 에칭 같은 특수한 표면 처리를 하거나 프라이밍 하여 접착력을 향상시킬 수 있습니다.

대부분의 경우, 실리콘 탄성중합체는 -50~200°C 의 온도 범위에서 장기간 사용이 가능합니다. 그러나 이 범위 내의 저온 및 고온 영역에서 개별 응용 제품에 따른 재료의 물성과 성능은 좀 더 복잡 하며 추가적인 주의가 요구됩니다.

9. 취급 및 주의사항

이 자료에는 취급시 주의사항이 들어있지 않으므로 제품을 사용하기 전에 이 제품의 물질안전에 관한 보건 자료와 취급 요령 및 신체, 건강상의 위험 요소에 대한 안내가 기재되어 있는 용기 라벨을 주의 깊게 읽으십시오.

물질안전보건자료는 당사 대리점이나 공급 업체를 통해 구하거나 당사 영업부로 신청하시기 바랍니다.

DOW 2577D

Page: 3 / 3

Rev. Date: 2021/05/31(1)

본 제품에는 톨루엔이 함유되어 있으므로 사용 중 열원, 불꽃을 피하여 주시고 사용시 피부 접촉, 흡입이 되지 않도록 주의 하시기 바랍니다.

톨루엔 이외의 용제를 희석하여 사용할 경우 사전에 당사기술팀과 협의가 이루어져야 하며 그렇지 않을 시 발생하는 문제에 대해서는 당사가 보증 책임지지 않습니다.

- ✧ 기타 필요한 자료는 당사 연구소나 영업에 문의하시면 자세한 사항을 받을 수 있습니다.
- ✧ MSDS 가 필요시 요청하시면 받아 보실 수 있습니다.